

Performance (micro)électronique, électrotechnique, électromécanique

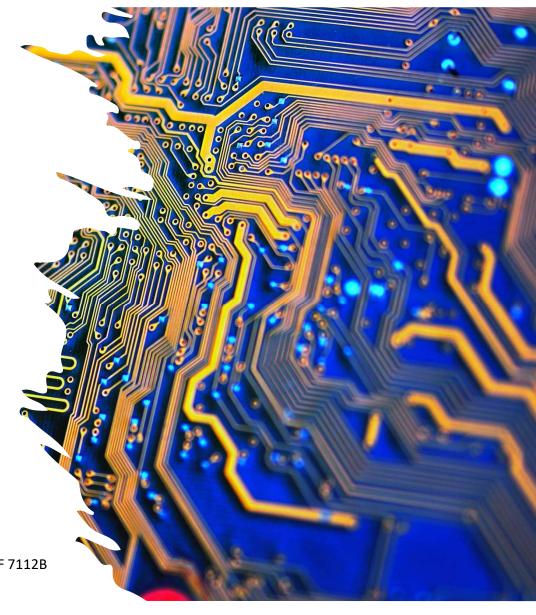
Consulting, Assistance technique, Prestations externalisées

FRAMATECH S.A. au capital de 38113 Euros

4 Boulevard d'Arras - 13004 Marseille - France Tél: +33 491 95 55 70 - Fax: +33 491 95 55 75

Organisme de formation N° 93 13 13363 13 - Siret 344 351 879 000 46 - NAF 7112B

Web: www.framatech.fr - E-mail: contact@framatech.fr





Nos atouts

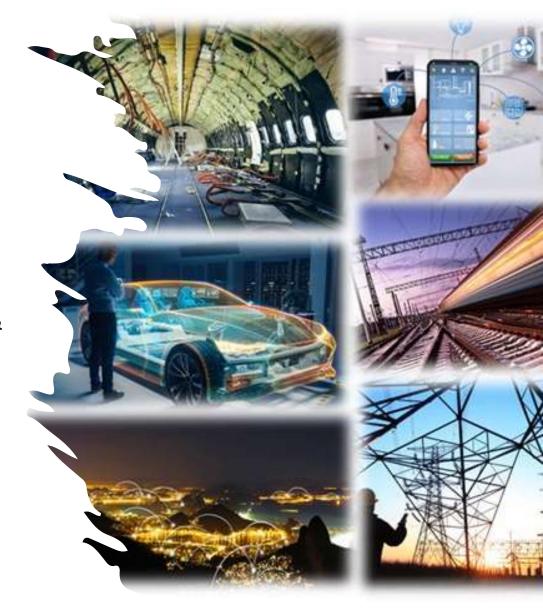
- Intervention sur tout ou partie de vos projets électroniques (conception, prototypage, fabrication, ... résolutions de problèmes)
 - Audit, diagnostic, suivi
 - Consulting
 - Assistance technique
 - Externalisation de tâches
- Par des experts métiers (seniors, industriels) & applications marchés
- Mobilisables à distance et/ou sur site, au plus près de vos équipes





Méthodologie d'intervention

- **Step 1** Prise en compte de votre demande & recueil de données (sous NDA)
- **Step 2** Création de l'équipe projet (pilotage & expertises)
- Step 3 Discussions techniques avec le Team Leader, & proposition (méthodologie d'intervention, interactivité, budget, délai)
- Step 4 Réalisation de la mission, coaching de l'équipe client & suivi





Composants

- Simulations en conception des composants en semiconducteurs (du wafer à la puce)
- Mise en œuvre de l'électronique de puissance « moderne » en SiC, GaN
- Choix technologiques & développement des boitiers (plastiques, céramiques,...) en packaging microélectronique
- Recherche & choix de soustraitants, audits,...
- Suivi en fabrication

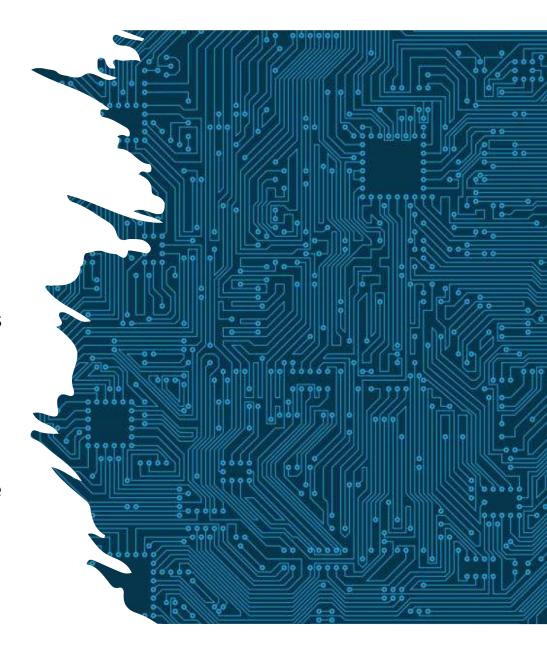






Design de cartes

- Assistance design, redesign to cost & fabrication PCBs (lay out, finitions,...)
- Assistance à la CAO des cartes électroniques, réduction des risques de défaillance (schémas électriques, routage de cartes,...)
- Assistance à l'intégration de composants (BGAs, QFN,...), DFR (design for reliability), DFR (design for manufacturing), DFT (design for test)
- Calculs CEM (étude topologique, règles d'implantation, découplage, routage, plans de masse,...)
- Adaptation aux exigences spécifiques (automobile, spatiale, etc...)





Assemblage & industrialisation des cartes

Evaluation des pratiques de fabrication du PCBA

 CMS (sérigraphie, pose, refusion), AOI (Automatic Optical Inspection), Brasage vague, ICT (In Circuit test), Conformal coating

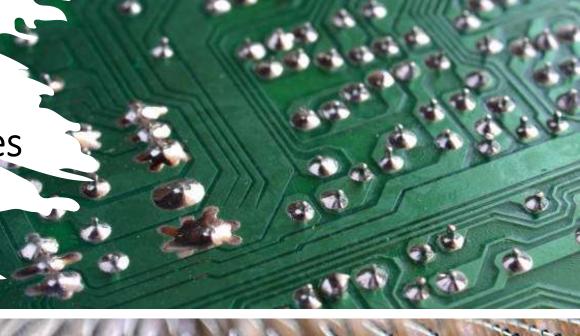
• Intégration du PCBA dans un boitier (plastique, métal,...), Final Fonctionnal Test

Optimisation de l'organisation interne du service industrialisation & Méthodes

 Fonction opérations, « gamistes » & gestion a configuration, « process » (analyse & capitalisation des procédés), « flux physiques » (équipements, tailles de lots, rendements, tests,...)

Aide à la conformité IPC-A-610

Assistance au rework (procédés & équipements de dessoudage/ressoudage, chip vs BGA)



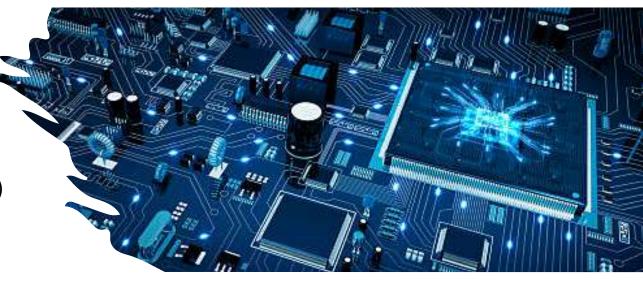




Fiabilité prévisionnelle, Essais accélérés, AMDEC Electronique

- Fiabilité prévisionnelle (MTBF)
- Démonstration de fiabilité
- Robustesse et déverminage
- Dimensionnement d'essais accélérés
- Analyse de défaillances
- Aide au montage de dossier AMDEC Electronique
- Aide à la qualification normative (ISO9001, AECQ100, IATF 16949, ...)







Robustification des cartes électroniques

- Analyse des contraintes (t°, gaz, humidité, immersion, vibrations, esthétisme,...)
- Aide aux choix technologiques des matériaux (vernis, résines, graisses,...) & bi-protection
- Analyse des impacts sur les composants
- Analyse des normes de référence de tenue aux environnements
- Analyse de mise en œuvre, process & choix des moyens de production
- Rédaction des plans de réalisation
- Evaluation des pratiques de robustification
- Prototypage



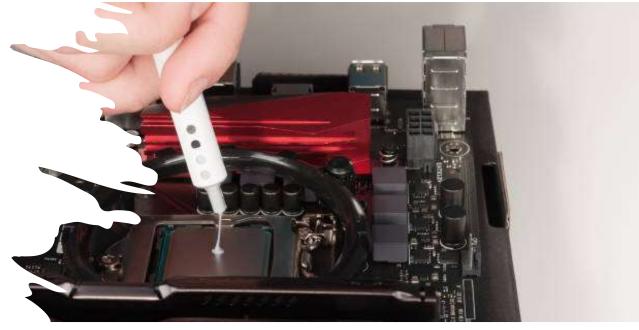


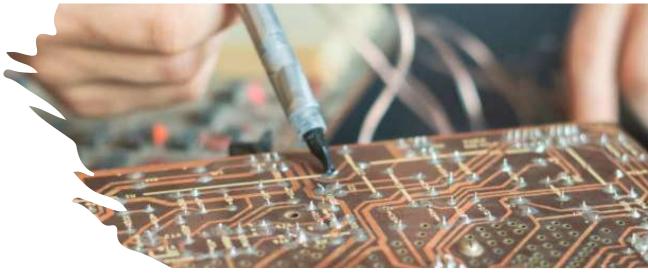


• FRAMATECH

Collage en électronique

- Revue des méthodologies de formulation
- Analyse des pratiques (process, atelier,...)
- Choix technologique des colles (applications, environnement, profil de vie)
- Aide à la mise en œuvre des adhésifs







Contact

Alain BARONI – <u>alain.baroni@framatech.fr</u> Tél. +33 491 955 570

Equipe

Stéphane B.

• Simulations, semiconducteurs

Didier S.

 Packaging microélectronique

Franck B.

• Fiabilité prévisionnelle, FIDES

Harry R.

 AMDEC électronique, MSP (maîtrise statistique des procédés, Plans d'expérience)

Jean-Luc B.

• CEM, hyperfréquences

Christian D.

• CAO électronique

Robert M.

 Procédés de fabrication des PCBA, Green belt 6 Sigma

Thierry B., Grégory G.

 Technologies & fabrication SiC, GaN

Roland D.

 Intégration de l'électronique de puissance dans les systèmes

Emmanuel M. & Christophe B.

 Robustification des cartes électroniques

Emmanuelle E.

 Collage conducteur & non conducteur en électronique



